



NEWS RELEASE

2021年5月25日

ヤマトホールディングス株式会社

光半導体技術を活用した IC チップ型 LiDAR を

開発する SiLC Technologies, Inc.へ出資

ヤマトホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾 裕）は、「KURONEKO Innovation Fund」（運営者：グローバル・ブレイン株式会社）を通じて、光半導体技術を活用したICチップ型LiDARを開発するSiLC Technologies, Inc.（本社：米国 / 以下、SiLC Technologies）に出資を実施しましたのでご報告いたします。

SiLC Technologiesは、光半導体技術を活用したICチップ型LiDAR（Light Detection And Ranging）を開発しています。LiDARは、レーザー光を対象物に照射し、その反射光を観測することで、対象物までの距離やその瞬間速度等を計測できる光学センサーです。機械による物体認識は、これまでカメラの2次元情報を基に行われることが主流でしたが、今後はカメラとLiDARを組み合わせた3D/4D情報（距離、瞬間速度の追加）を基にしたより高度なものに進化しようとしています。さらにその技術は今後、監視カメラ、産業ロボット、自動運転やADAS（Advanced Driver Assistance System 先進運転支援システム）、AR/VR用のコンシューマーデバイスといった幅広い産業で活用が期待されています。SiLC TechnologiesのICチップ型LiDARは、センサー性能、ICチップ統合技術、製造ノウハウの面で高い競争優位性を誇っています。

今回、「KURONEKO Innovation Fund」のポートフォリオにSiLC Technologiesを組み入れることで、LiDARにおける先端技術の知見を得るとともに、自動化された産業ロボットや自動運転などの活用に向けた可能性を探っていきます。

SiLC Technologiesについて

設立：2018年2月

本社所在地：Monrovia, CA, United States

代表者：Mehdi Asghari

事業内容：ICチップ型LiDARを開発

WEBサイト：<https://www.silc.com/>

KURONEKO Innovation Fundについては以下のURLを参照願います。

<https://kif.yamato-dx.com/>

以上

【メディアからのお問合せ】

ヤマトホールディングス（株） コーポレートコミュニケーション担当 TEL：03-3248-5822